

证券代码：300657

证券简称：弘信电子

公告编号：2023-99

## 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知以电话、电子邮件相结合的方式于2023年11月27日发出。会议于2023年12月1日上午10:00以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，出席本次会议董事9人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。

本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

### 一、董事会会议审议情况

经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过如下决议：

**1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于签署“兴办软硬结合板生产项目”之补充协议二的议案》**

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的有关公告。

### 二、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《关于签署兴办软硬结合板生产项目之补充协议二的公告》。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年12月1日